

NEWS RELEASE

光半導体事業の生産能力増強のため
本社工場に新棟を建設
地鎮祭は6月30日

2023年6月23日
浜松ホトニクス株式会社
本社：浜松市中区砂山町 325-6
代表取締役社長：丸野 正(まるの ただし)

当社は、光半導体製品の需要拡大に対応するため、本社工場（浜松市東区市野町）に光半導体製造（前工程）を担う新棟を建設します。

新棟建設の地鎮祭は6月30日（金）に執り行い、2025年6月に竣工の予定です。



当社は、医療や産業、自動車などのさまざまな分野に光半導体製品を供給しています。今後、光半導体製品のさらなる需要拡大が見込まれることから、本社工場に新棟を建設し前工程の生産能力を増強します。

新棟建設により、生産スペースを従来の約2倍に拡張します。また、従来の直径6インチシリコンウエハの生産ラインに加え、新棟に直径8インチウエハ対応の製造ラインを採用することで、生産の継続性を担保するとともに生産効率の向上やコストダウンも図ります。さらに、新棟と既存棟をクリーンルーム内で接続し人や物の移動を効率化するとともに、自動搬送システムの導入により製造工程の自動化と省人化を進めます。

なお、新棟は耐震構造を採用し災害対策を強化するとともに、環境配慮型の製造装置を導入します。

当社は、新貝工場（浜松市南区新貝町）に後工程を担う新棟も建設しており、今回の投資を含め生産体制を強化することで、今後の継続的な成長を支えます。

新棟の地鎮祭および概要につきましては以下の通りです。

<地鎮祭>

式典名称 浜松ホトニクス株式会社 本社工場5棟建設工事 地鎮祭
日 時 2023年6月30日（金） 午前10時00分～
場 所 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1

<新棟概要>

建物名称 本社工場5棟
建築場所 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1
建築工期 2023年7月着工、2025年6月竣工予定
稼働予定 2025年12月
建築構造 地上4階、地下1階
(生産棟) 柱：RC造、梁：S造
(機械棟) S造
建物面積 3,083.13㎡
延床面積 10,960.86㎡
施設構成 B階 倉庫、機械室
1階 光半導体製品の生産補助階（前工程）、機械室
2階 光半導体製品の生産実行階（前工程）、機械室
3階 光半導体製品の生産補助階（前工程）、電気室
4階 光半導体製品の生産実行階（前工程）、電気室
総工費 約370億円（生産設備を含む）
収容人員 約40名
生產品目 光半導体製品
生産能力 約8,000枚／月（8インチウエハ換算）

以上



本社工場 5 棟 完成予想図

<この件に関するお問い合わせ先>

■報道関係の方 浜松ホトニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 野末迪隆
〒430-8587 浜松市中区砂山町 325-6 日本生命浜松駅前ビル
TEL053-452-2141 FAX053-456-7888 E-mail: nozue-m@hq.hpj.co.jp
時間外は、携帯電話 080-8262-0374 へお願いします